



株式会社フェローテックホールディングス

24/3期 決算説明

2024.5.31(金)

1. 当期連結決算においては、連結子会社は2023年1月～2023年12月末の業績を連結しております。
2. 本資料は、24/3期決算の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社株式の購入や売却等を勧誘するものではありません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われるようお願いいたします。
3. 本資料は開示日現在のデータに基づいて作成されております。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり予告なしに変更されることがあります。

連結決算サマリー

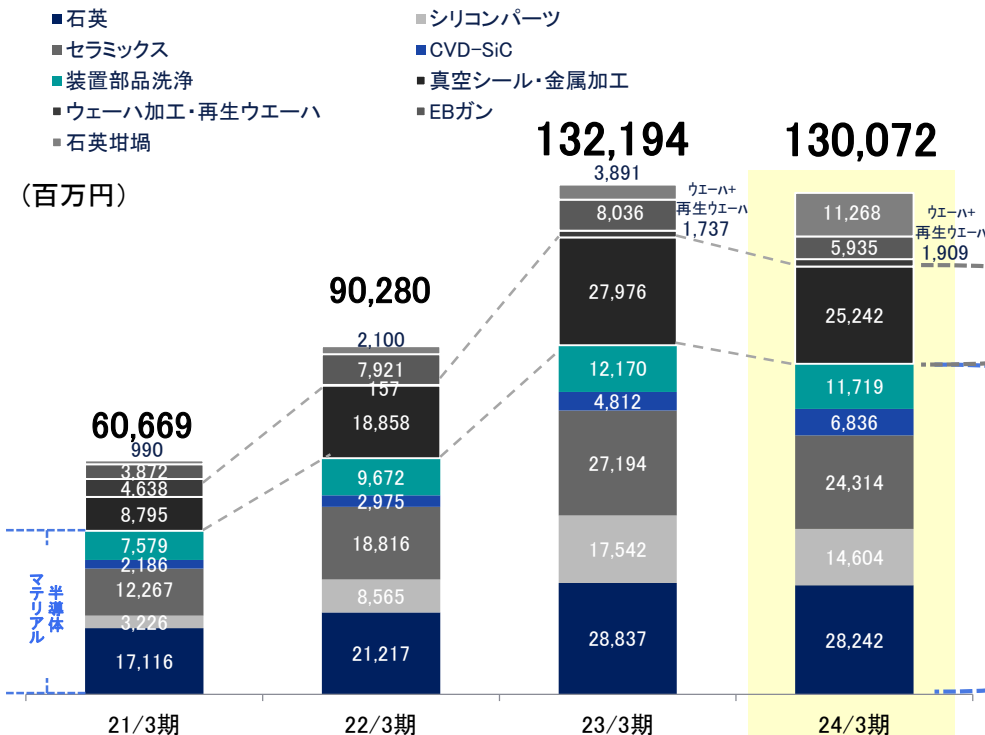
(百万円)	23/3期	24/3期	前期比		
	金額	金額	金額	増減率(%)	
売上高	210,810	222,430	11,620	5.5	売上高: 前期比+5.5% 売上総利益: 前期比-3.1% ・パワー半導体基板、センサ売上増も、セラミックス、Siパーツ等マテリアル製品は減少 ・工場新設・設備投資による減価償却等の原価増加もあり粗利減少
売上原価	138,728	152,573	13,844	10.0	
売上総利益	72,081	69,856	△ 2,224	△ 3.1	
販売管理費	37,038	44,984	7,945	21.5	販管費: 前期比+21.5%、マレーシア等新会社、新事業増に加え、労務費、試験研究費増加 営業外収益: 前期比-18.7億円(為替差益-41.1億円、補助金収益+8.6億円) 営業外費用: 前期比+38.7億円(ウエーハ、SiCウエーハ等持分法損失+31.3億円)
営業利益	35,042	24,872	△ 10,170	△ 29.0	
営業外収益	9,872	8,002	△ 1,870	△ 18.9	
営業外費用	2,466	6,337	3,870	156.9	
経常利益	42,448	26,537	△ 15,911	△ 37.5	
特別利益	856	754	△ 101	△ 11.9	特別利益7.5億円: 持分変動利益7.1億円(SiCウエーハへの現物出資) 特別損失11.5億円: 投資有価証券評価損5.2億円、減損損失4.2億円 非支配株主持分利益54.8億円 ・シリコンパーツ石英坩堝事業: 21.6億円 ・パワー半導体事業: 29.9億円 ・洗浄事業: 8.9億円 ・再生ウエーハ事業: -5.3億円
特別損失	1,263	1,145	△ 117	△ 9.3	
非支配株主に帰属する当期純損益	4,585	5,481	895	19.5	
親会社株主に帰属する当期純利益	29,702	15,154	△ 14,548	△ 49.0	
投資額*	62,660	78,599	15,938	-	
減価償却費	12,618	16,398	3,779	30.0	
為替レート(期中平均)	米ドル: 132.08円 人民元: 19.50円	米ドル: 141.20円 人民元: 19.87円	-	-	

セグメント別売上高および営業利益

売上高 (単位:百万円)	23/3期		24/3期		前期比	
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	増減額	増減率(%)
半 導 体 等 装 置 関 連	132,194	62.7	130,072	58.5	△ 2,122	△ 1.6
電 子 デ バ イ ス	53,024	25.2	67,600	30.4	14,575	27.5
そ の 他	25,590	12.1	24,757	11.1	△ 832	△ 3.3
合 計	210,810	100.0	222,430	100.0	11,620	5.5

営業利益 (単位:百万円)	23/3期		24/3期		前期比	
	金額	利益率(%)	金額	利益率(%)	増減額	増減率(%)
半 導 体 等 装 置 関 連	24,090	18.2	16,260	12.5	△ 7,830	△ 32.5
電 子 デ バ イ ス	11,178	21.1	10,890	16.1	△ 288	△ 2.6
そ の 他	597	2.3	△ 1,197	-	△ 1,795	-
全 社 消 去	△ 824	-	△ 1,080	-	△ 256	-
合 計	35,042	16.6	24,872	11.2	△ 10,170	△ 29.0

売上高の推移



セグメント総括

セラミックス、シリコンパーツ、真空シール・金属加工等が前同比減少、石英坩堝、CVD-SiCは増加も-21億円

真空シール・金属加工、ウエーハ加工・再生ウエーハ

真空シール・金属加工が半導体装置生産低迷の影響により前期比-12億円も、下期は回復基調(下期売上は上期比+22%)

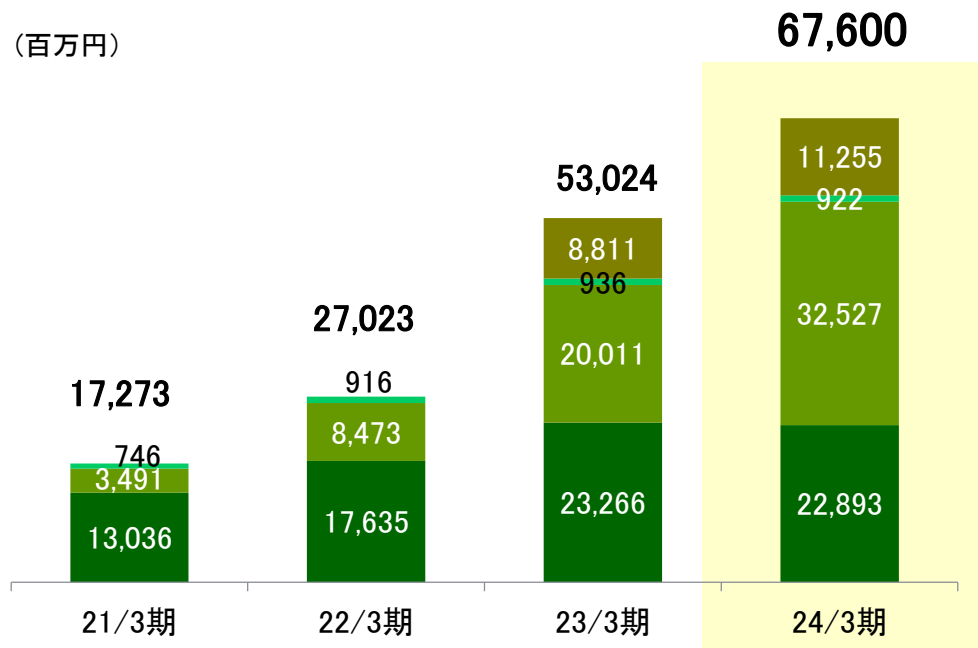
半導体マテリアル、洗浄事業

- 【半導体マテリアル (石英、シリコンパーツ、セラミックス、CVD-SiC)】
- 石英: 既存半導体装置メーカー向け機械加工品が低迷、火加工品増強も売上は前期比-6億円の減少、利益率も低下
 - シリコンパーツ: 半導体生産・装置生産低迷から-29億円
 - セラミックス: 半導体生産・装置生産低迷から-29億円
 - CVD-SiC: 需給底堅く、岡山工場キャパ増強により+20億円
- 【洗浄事業】
- 半導体生産低迷により-5億円、下期売上は上期+16%
- 【石英坩堝】
- 大型坩堝がPV向け増加+74億円、需要変動激しく4Qは低迷

売上高の推移

- サーマモジュール
- パワー半導体基板
- 磁性流体、他
- センサ

(百万円)



セグメント総括

・電子デバイスは、パワー半導体基板の売上拡大、センサの大泉製作所連結化効果から、前期比+146億円

【サーモモジュール】

・医療検査機器向けピークアウト、通信機器向けも一服、-2億円

【パワー半導体基板】

・DCB基板及びAMB基板の需要堅調、東台等生産キャパ増加の効果から売上増加継続、+123億円、4Qは発注調整等あり売上減少

【センサ】

・大泉製作所連結化(2023/3期2Q)により+24億円

連結貸借対照表 ～資産～

(百万円)	23/3期 期末	24/3期 期末	増減額
流動資産	215,341	248,408	33,066
現金及び預金	103,115	117,254	14,139
受取手形及び売掛金	53,276	61,940	8,663
たな卸資産	49,177	56,909	7,731
固定資産	195,306	261,618	66,312
有形固定資産	139,610	201,339	61,729
建物及び構築物	38,080	66,583	28,503
機械装置及び運搬具	44,171	59,533	15,361
工具、器具及び備品	5,984	7,468	1,484
土地	4,451	4,660	209
リース資産(純額)	11,009	12,018	1,009
建設仮勘定	35,913	51,075	15,161
無形固定資産	6,949	6,611	△ 338
のれん	2,304	2,010	△ 294
投資その他資産	48,745	53,666	4,921
資産合計	410,648	510,026	99,378

【流動資産の主な増加要因等】

- ・現預金+141億円（麗水センサ新会社+124億円、マレーシア新会社+104億円等）
- ・売上債権及び棚卸資産が、売上増加に伴い増加

【有形固定資産、無形固定資産の主な増加要因等】

- ・マレーシア設備投資等により有形固定資産+617億円（マレーシアFTMM +166億円、常山シリコンパーツ+45億円、常山セラミックス等+61億円、四川 パワー基板+78億円、銀川FTNC 石英坩堝等+71億円、日本FTMT・FTHD59億円等）

【投資その他資産の主な増加要因等】

- ・投資有価証券、繰延税金資産、その他資産等増加+49億円

連結貸借対照表 ～負債及び純資産～

(百万円)	23/3期 期末	24/3期 期末	増減額
流動負債	111,294	122,148	10,854
支払手形及び買掛金	40,524	38,334	△ 2,189
短期借入金	20,378	26,454	6,076
1年内返済長期借入金 +1年内償還社債	15,825	21,022	5,197
固定負債	49,697	109,712	60,014
社債	4,083	320	△ 3,763
転換社債型新株予約権付社債	-	25,000	25,000
長期借入金	26,432	62,364	35,931
負債合計	160,991	231,860	70,869
純資産	249,656	278,166	28,509
株主資本	166,955	177,638	10,682
その他の包括利益累計額	16,773	26,771	9,997
非支配株主持分	65,887	73,756	7,869
負債・純資産合計	410,648	510,026	99,378
自己資本比率	44.7%	40.1%	-4.6pt
為替レート(期末レート)	米ドル:132.70円 人民元:19.01円	米ドル:141.83円 人民元:19.93円	-

【流動負債、固定負債の主な変動要因等】()内は2023/3期末比

短期借入+1年内長借・社債	475億円 (+113億円)
長期借入+社債・転換社債	877億円 (+572億円)
有利子負債 合計	1,352億円 (+684億円)

【純資産の主な変動要因等】

- ・株主資本 +107億円(利益剰余金+102億円)
 - ・その他の包括利益累計額+100億円
(為替換算調整勘定 +88億円)
 - ・非支配株主持分 +60億円
(パワー半導体基板+41億円、シリコンパーツ・坩堝+29億円、
洗浄+14億円)
- 【自己資本比率】**
- ・自己資本比率40.1%

キャッシュフロー計算書

(百万円)	23/3期	24/3期
営業活動によるキャッシュフロー	43,024	28,720
税金等調整前四半期純利益	42,041	26,146
減価償却費	12,618	16,398
為替差損益(△:益)	△ 1,402	△ 798
売上債権の増減(△:増加)	△ 3,139	△ 4,919
たな卸資産の増減(△:増加)	△ 14,354	△ 5,177
仕入債務の増減(△:減少)	6,516	△ 4,472
持分変動損益(△:益)	△ 651	△ 710
その他	1,395	2,252
投資活動によるキャッシュフロー	△ 68,760	△ 92,400
有形固定資産取得による支出	△ 56,001	△ 74,489
有形固定資産の売却による収入	236	259
無形固定資産の取得による支出	△ 976	△ 737
投資有価証券の取得による支出	△ 4,607	△ 2,098
その他	△ 7,412	△ 15,335
財務活動によるキャッシュフロー	68,718	60,419
短期借入金の増減額	11,687	5,314
長期借入れによる収入	24,256	57,734
長期借入金の返済による支出	△ 8,311	△ 16,860
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	-	24,898
非支配株主からの払込みによる収入	47,607	5,183
その他	△ 6,521	△ 15,850
現金及び現金同等物の増加額	43,326	901
現金及び現金同等物の期首残高	52,579	95,905
現金及び現金同等物の期末残高	95,905	96,806

【営業CFの状況】

減価償却: 164 億円、前期比+38億円

売上債権・棚卸資産・仕入債務の増減: △146億円

【投資CFの状況】

有形固定資産の取得: △745億円

その他: △153億円
・定期預金純増減 △141億円

【財務CFの状況】

非支配株主からの払込みによる収入: 52億円

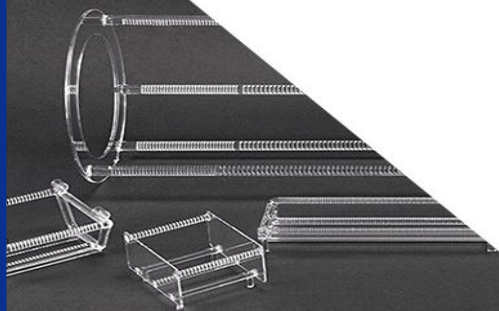
・麗水センサ 50億円
その他: △159億円
・社債の償還 △47億円
・配当金支払 △49億円
・子会社株式の取得 △59億円(大泉製作所株式)



FerroTec
Ferrotec Holdings Corporation



2025年3月期 通期業績予想

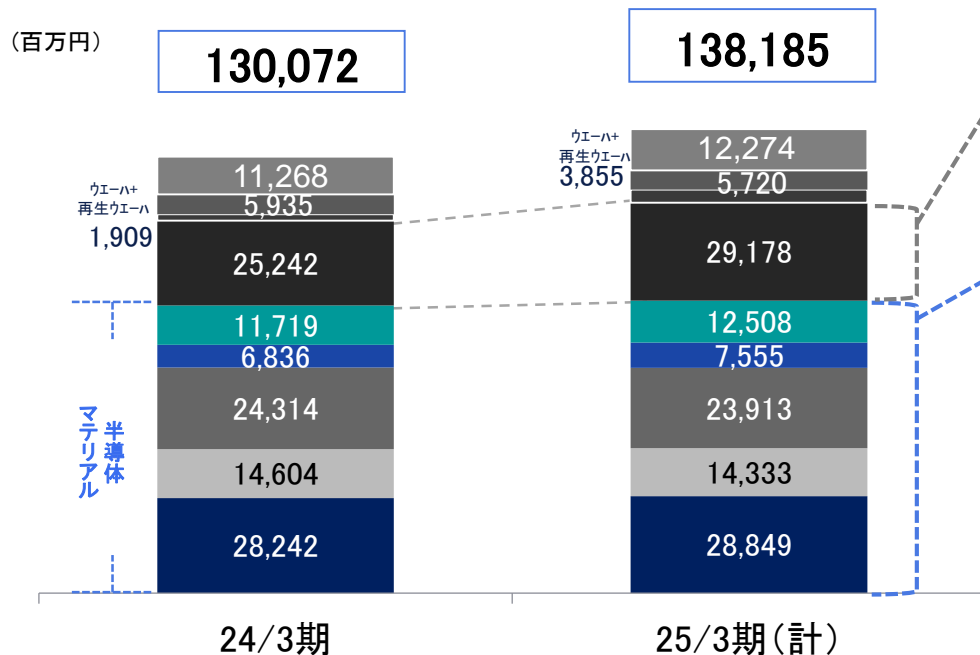


(百万円)	24/3期	25/3期(計)	前期比(%)	計画の詳細・前提
売上高	222,430	235,000	5.7	・半導体装置製造は復調、真空シール・金属加工も回復の見通し
営業利益	24,872	26,000	4.5	・マテリアル製品は在庫要因から回復ずれ込む想定 ・工場新設等により減価償却・費用増加見通し
経常利益	26,537	26,000	△ 2.0	・前期の為替差益14億円剥落
親会社に帰属する 当期純利益	15,154	16,000	5.6	・特別損益の発生は予定せず
減価償却費	16,398	20,000	22.0	・新增設工場立上げにより減価償却費が増加
EBITDA	41,270	46,000	11.5	—
投資額*	78,599	63,000	△ 19.8	半導体マテリアル・金属加工投資(マレーシア、石川等)、パワー基板(四川、マレーシア)、麗水センサー
想定為替レート設定(期中平均)	米ドル: 141.20円 人民元: 19.87円	米ドル: 150円 人民元: 21円	-	下期円高予想も、事業会社12月決算にてこの設定

注 投資額＝有形資産、無形固定資産、有価証券の取得等の合計

売上高の推移

- 石英
- セラミックス
- 装置部品洗浄
- ウェーハ加工+再生ウェーハ
- 石英坩堝
- シリコンパーツ
- CVD-SiC
- 真空シール・金属加工
- EBガン



セグメント総括

- ・半導体装置製造が復調、真空シール・金属加工は回復・売上増加
- ・半導体マテリアル製品も、先行き増勢ながら、2024年は顧客在庫調整の要因から回復が遅れると想定

真空シール・金属加工

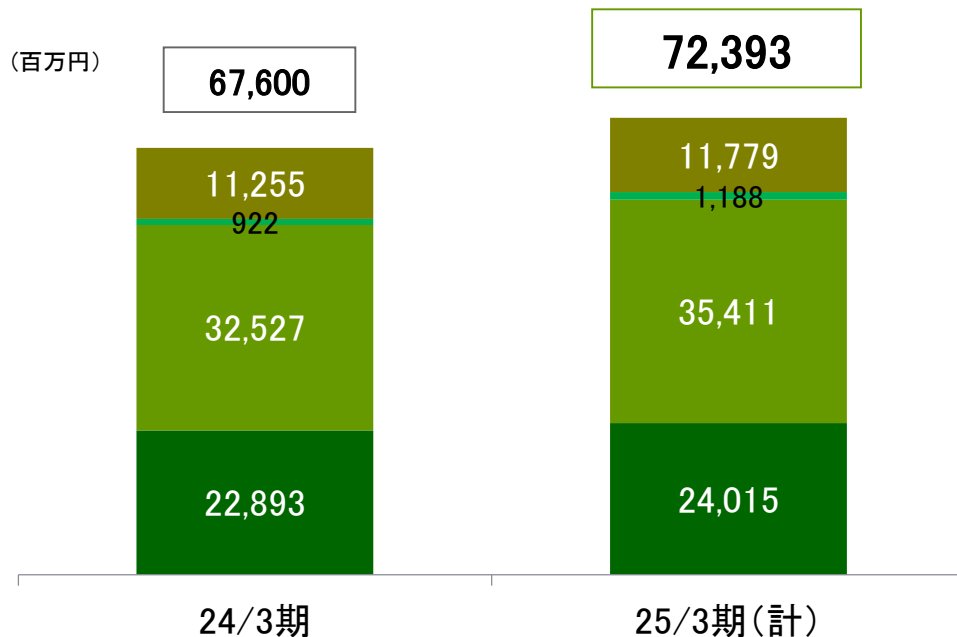
- ・半導体製造装置メーカーの真空シール・金属加工売上は前期後半から復調、2024年は同様水準が継続すると想定

半導体マテリアル、洗浄事業

- 【半導体マテリアル（石英、シリコンパーツ、セラミックス、CVD-SiC）】
- ・石英：顧客在庫要因から回復ずれ込む想定とし、前年微増
 - ・シリコンパーツ：顧客在庫要因が大きい想定、前年微減
 - ・セラミックス：顧客在庫要因から回復ずれ込む想定とし、前年微増
 - ・CVD-SiC：需要堅調、前期後半の水準が継続する想定
- 【石英坩堝・洗浄事業】
- ・石英坩堝：前年に銀川キャパ増も、PV需要の変動大にて前期+9%
 - ・洗浄：前期後半から需要復調、同水準が継続する想定

売上高の推移

■ サーモモジュール ■ パワー半導体基板 ■ 磁性流体・その他 ■ センサ



セグメント総括

・パワー半導体基板の売上拡大が継続、サーモモジュールも売上復調を予想

【サーモモジュール】

・5G通信機器向けは復調トレンド、生成AI関連需要増加見込む

【パワー半導体基板】

・DCB基板及びAMB基板の成長増加の継続見込む

前年第4四半期は発注調整あるも、EV向け等の需要増加の趨勢は継続見通し好調、増産投資の効果により大幅増収

【センサー】

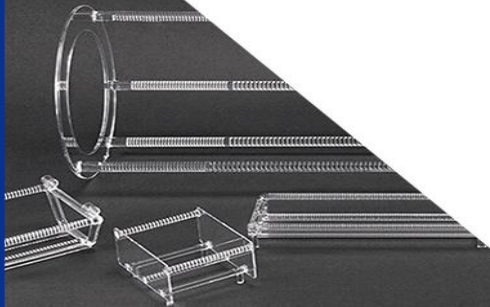
・自動車、エアコン向け中心に、前期並みを予想



Ferrotec
Ferrotec Holdings Corporation

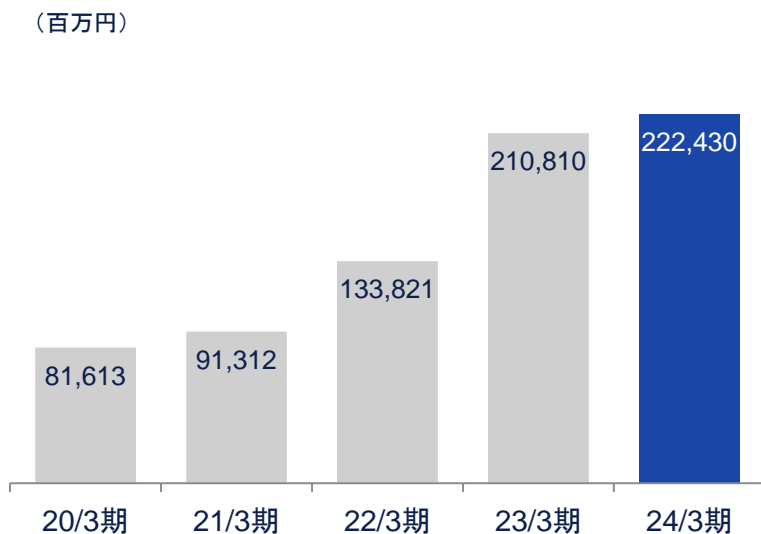


中期経営計画 (25/3期～27/3期)

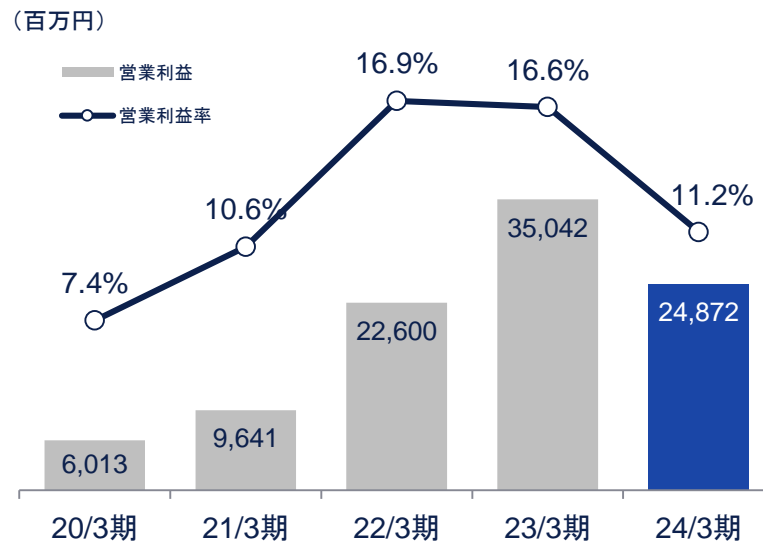


- 半導体マーケット低迷のなか、パワー半導体基板の増強等を進め、売上増加
- マレーシア等へ積極投資を実行、生産準備は順調も立上げ段階、営業減益

連結売上高



連結営業利益



中期経営計画KPI 振り返り

(金額の単位は百万円)	策定時 実績	24/3期 計画値		結果
	21/3期(実)	策定当初	修正後	24/3期(実)
売上高	91,312	150,000	220,000	222,430
営業利益	9,640	25,000	32,500	24,872
営業利益率	10.6%	16.7%	14.8%	11.2%
当期純利益	8,280	15,000	18,000	15,154
ROE	14.3%	15%	15%	7.7%
ROIC*	7.2%	8%	8%	4.4%
自己資本比率	37.9%	40%超	40%超	40%
投資額	14,297	26,000	96,900	78,599
1株当たり年間配当金	30.0円	利益成長による増加		100.0円

*ROIC = 親会社帰属純利益/(有利子負債+純資産) 純資産は新株予約権、非支配株主持分除く
 投資額=有形資産、無形固定資産、有価証券の取得等の合計

事業成長

- 21/3期⇒24/3期に売上913億円⇒2,218億円へ2.43倍、営業利益96億円⇒250億円へ2.60倍の成長
- 24/3期は半導体市況悪化の影響受けるも、主要製品の業界ポジションは向上、成長トレンドは継続

グローバル 生産体制の強化

- 中国拠点の増強(常山、四川等)に加え、マレーシアのクリム及びジョホール、日本・石川(第2、第3)及び熊本と中国外拠点を拡充
- 生産キャパの増強と共に、米中摩擦等を背景とした顧客ニーズへの対応強化

経営基盤 の強化

- 品質管理の強化、生産のデジタル化・自動化が大幅に進展(自動化装置、AI検査機器、自動化倉庫導入等)、各事業の研究・開発体制を拡充
- 技術・営業・管理・技能工等の人材強化が進捗、中国本部を設立

財務・ 株主還元

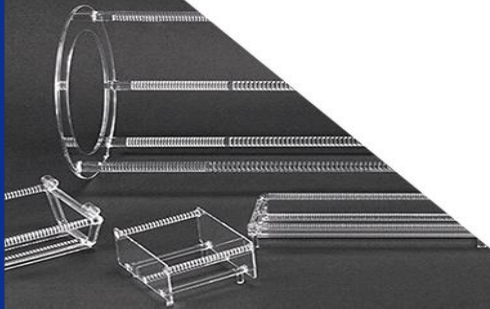
- 24/3期は新設拠点等が未稼働段階にあることと、半導体市況悪化の影響が重なり減益
- 23/3期から「配当性向20%を意識して判断」の方針とし株主還元を強化



Ferrotec
Ferrotec Holdings Corporation



中期経営計画の基本方針、KPI、財務



事業成長

- 半導体、自動車関連の事業成長を追求し、業界上位の事業を拡大させる
- マレーシア、日本工場が中国外製造品の需要を取込み、中国工場が中国製造品の需要を取込む体制を強化する

生産効率・ 競争力の強化

- 当社の量産能力を更に高めるため、デジタル化・自動化等を進め、工場の生産効率向上・競争力強化を追求する
- 「品質は命」と考え品質管理の徹底を継続、研究開発体制を強化、新製品・新技術の開発を推進する

人材強化・ 企業文化

- 人材重視を重要な経営戦略と位置付け、高度人材の採用、研修制度の拡充、株式報酬制度(RSU・PSU)導入を進める
- 企業文化は企業の礎であり、「顧客を尊敬、従業員を尊敬し、勤勉と信用を尊重し、着実に行動し、革新を追求する」を活動指針に掲げ、浸透を進める

財務・ 株主還元

- 新增設工場の早期立上げ・業績貢献により、収益増強を図る
- 株主還元増加を重視、配当性向は20%~30%を意識、株主還元の拡充に努める

(金額の単位は百万円)	24/3期(実)	25/3期(予)	26/3期(計)	27/3期(計)
売上高	222,430	235,000	300,000	380,000
営業利益	24,872	26,000	40,000	60,000
営業利益率	11.2%	11.1%	13.3%	15.8%
当期純利益	15,154	16,000	22,000	30,000
ROE	7.7%	→		15%
ROIC*	4.4%	→		8%
自己資本比率	40%	40%		
設備投資	75,227	60,000	40,000	40,000
1株当たり配当金(年間)	100.0円	100.0円	財務・投資機会の状況を考慮 配当性向20%~30%を意識、拡充に努める	

*ROIC = 親会社帰属純利益/(有利子負債 + 純資産) 純資産は新株予約権、非支配株主持分除く

- 3か年の設備投資は累計1,400億円を計画、M&Aは投資機会により変動するが100億円を想定
- マレーシア投資設備支払い時期が25/3期に一部ズレた影響等あり。21/3～24/3投資金額は計画1,950億円に対し1,825億円*、計画比マイナス125億円 *24/3期子会社株式取得(財務CF計上)を含む

25/3期～27/3期累計

設備投資

1,400億円

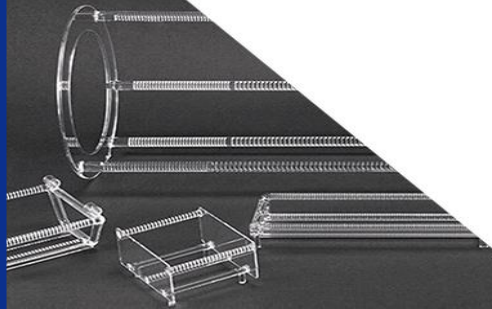
- 半導体関連顧客からの2025年以降のキャパシティ増強の要請へ対応
- 中国外生産体制を強化
- パワー半導体基板等の自動車セグメントへの投資を継続
- 営業CFの増加により、フリーCFは改善見通し



Ferrotec
Ferrotec Holdings Corporation



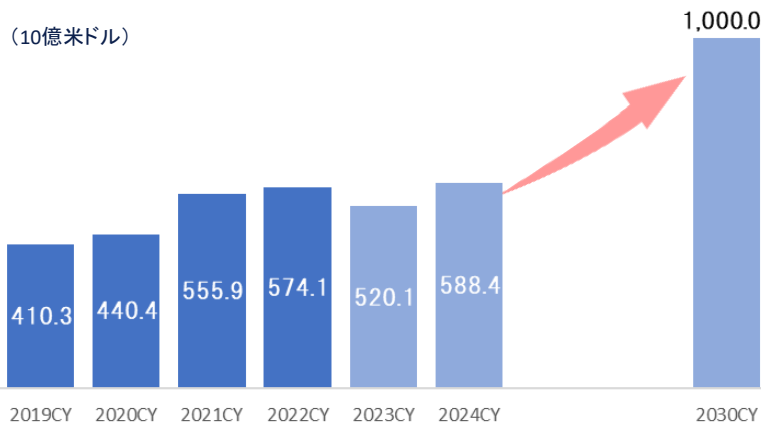
市場環境、長期業績トレンド



半導体市場は2024年より回復、2025年以降成長加速へ

- 半導体市場は2030年には1兆米ドルを超える規模へ。製造装置需要も2024年から上昇基調
- 米中半導体摩擦の影響はあるものの、ボリュームゾーンを押さえる中国は成長が見込まれると予想

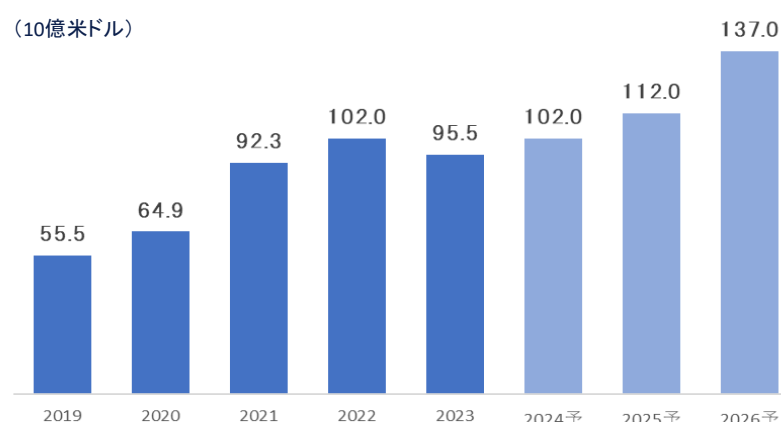
半導体市場予測



(10億米ドル)	2019CY	2020CY	2021CY	2022CY	2023CY	2024CY
半導体需要	410.3	440.4	555.9	574.1	520.1	588.4
前年比成長率	-0.5%	+7.3%	+26.2%	+3.3%	-9.4%	+13.1%

*出典: WSTS等のデータを基に当社作成

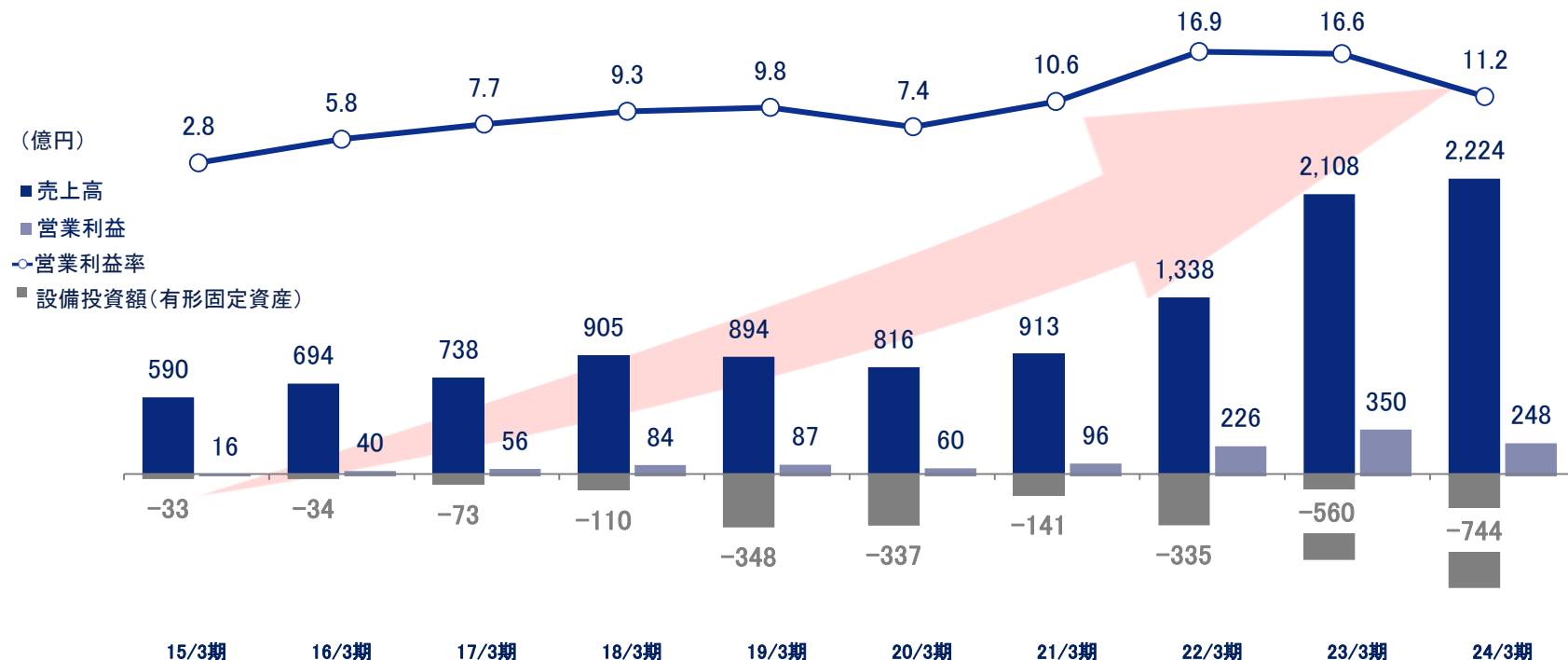
WFE(半導体製造装置前工程)市場予測



(10億米ドル)	2019	2020	2021	2022	2023	2024予	2025予	2026予
WFE市場金額	55.5	64.9	92.3	102.0	95.5	102.0	112.0	137.0
前年比成長率	-6.0%	+16.9%	+42.2%	+10.5%	-6.4%	+6.8%	+9.8%	+22.3%

*某証券会社資料を基に当社作成

- 2019年～2021年の積極投資(常山・東台・銅陵工場新增設等)、生産キャパ増強により、
2021年～2023年の当社売上・利益が大幅に伸長した ⇒投資から3年程度内で収益貢献が実現

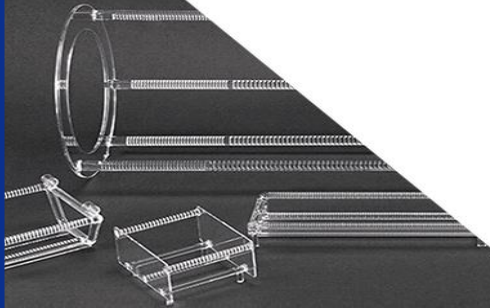




Ferrotec
Ferrotec Holdings Corporation

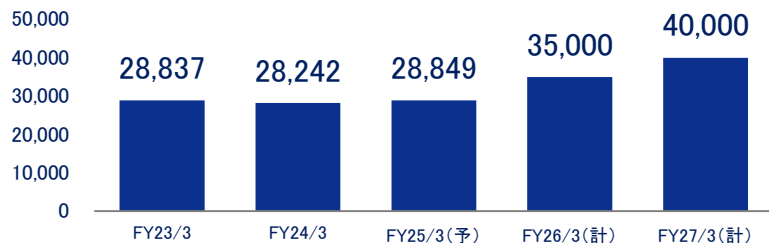


注力製品別戦略



売上高の推移

(百万円)



量産スケジュール

	FY2024	FY2025	FY2026
マレーシア工場	稼働開始	稼働	本格稼働
熊本工場	—	稼働開始	稼働

マレーシア、熊本で計200億円超のキャパ増強



常山第二期工場(石英)



石英製品(火加工品)

【2023年総括】

- ・半導体マーケット減速、中国市場の成長取り込みにより挽回を図り、売上は横這い
- ・マレーシアの新工場設立、火加工技能工の人員増加

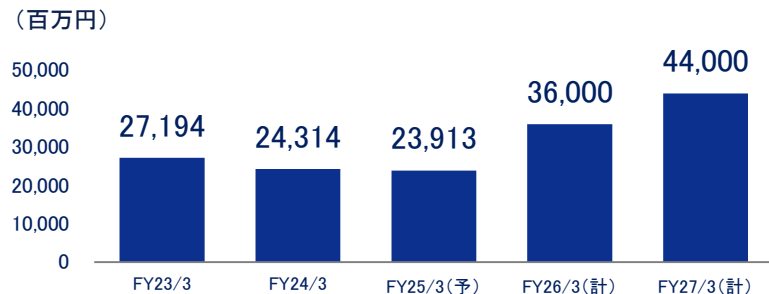
【中期業績見通し】

- ・ユーザー在庫消化の影響を織り込み、回復本格化は2025年以降
- ・欧米顧客の中国外製品のニーズはマレーシア工場対応

【投資・キャパ】

- ・2025年以降の需要増加に対しキャパ拡充、火加工キャパ引上げにより機械加工需要も増加、2024年はマレーシア投資支出見込

売上高の推移



量産スケジュール

	FY2024	FY2025	FY2026
常山工場	稼働開始	稼働	本格稼働
マレーシア工場	稼働開始	稼働	本格稼働
石川工場(三期)	—	稼働開始	稼働

常山、石川、マレーシアで計150億円超のキャパ増強



常山第三期工場(セラミックス)



ファインセラミックス製品

【2023年総括】

- ・半導体マーケット減速の影響受け、中国市場拡大も、11%減収
- ・常山、石川、マレーシア新工場設立、キャパ増加へ積極投資実行

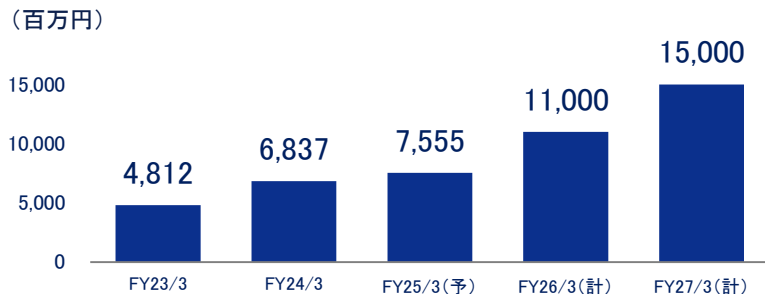
【中期業績見通し】

- ・ユーザー在庫消化の影響を織り込み、回復本格化は2025年以降
- ・欧米顧客の中国外製品のニーズはマレーシア・日本工場に対応

【投資・キャパ】

- ・2024年はマレーシア投資支出見込む、新工場の稼働により、生産キャパ拡大

売上高の推移



量産スケジュール

	FY2024	FY2025	FY2026
常山工場	稼働開始	稼働	本格稼働

常山、岡山で100億円程度のキャパ増強



常山第三期工場 (CVD-SiC)



CVD-SiC 製品

【2023年総括】

- ・半導体マーケット減速も需要堅調、岡山工場キャパ増、42%増収
- ・岡山工場キャパ増に加え、常山工場を立上げ

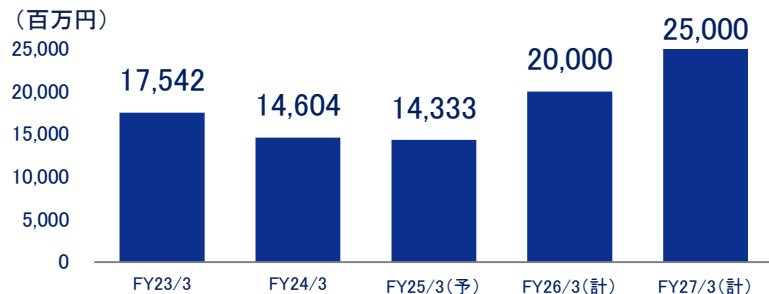
【中期業績見通し】

- ・半導体顧客のCVD-SiC需要は拡大継続する見通し
- ・当社生産能力の増強により、売上増加を図る

【投資・キャパ】

- ・常山工場及び岡山工場の生産能力の増強を進める

売上高の推移



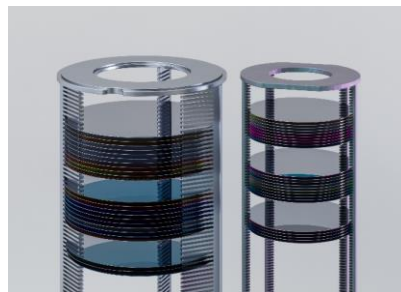
量産スケジュール

	FY2024	FY2025	FY2026
常山工場	稼働開始	稼働	本格稼働

常山、銀川で100億円程度のキャパ増強



常山第三期工場 (Si-Parts)



シリコンパーツ製品

【2023年総括】

- ・ 半導体マーケット低迷の影響を受け、売上減少
- ・ 中長期的には需要拡大が見込まれ、常山工場新設、キャパ増強

【中期業績見通し】

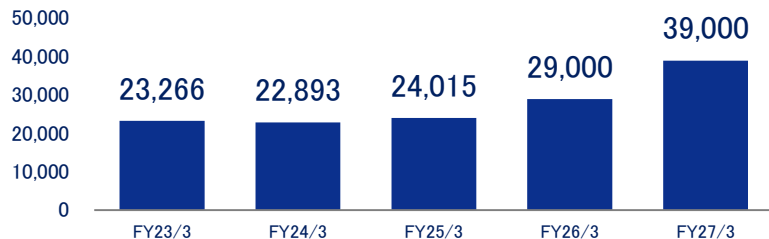
- ・ 2024年は在庫影響により売上増加ないと想定
- ・ 2025年以降は需要拡大、キャパ増加効果により売上拡大見通し

【投資・キャパ】

- ・ 常山工場を新設、銀川工場の増強等により、キャパ増加を計画

売上高の推移

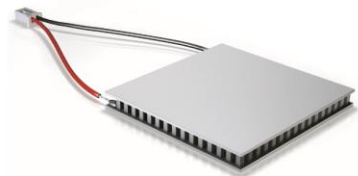
(百万円)



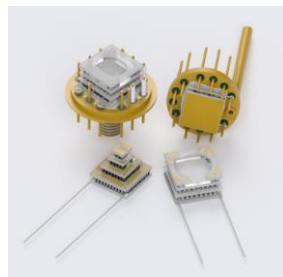
自動化・効率化の進展



- ・自動化・省人化・効率化
- ・組立の自動化装置導入
- ・検査のAI化・自動化
- ・搬送の自動化(AGV)
- ・自動化倉庫の導入



スタンダードモジュール



光通信用
マイクロモジュール

【2023年総括】

- ・PCRなどバイオ装置向けピークアウト、5G通信機器向け調整局面
- ・生成AI関連光トランシーバー向けが増加

【中期業績見通し】

- ・5G通信機器向けは復調、増加トレンド、生成AI関連増加継続
- ・中国5G-A(5.5G)投資・需要増期待、冷却チラー拡充、拡販目指す

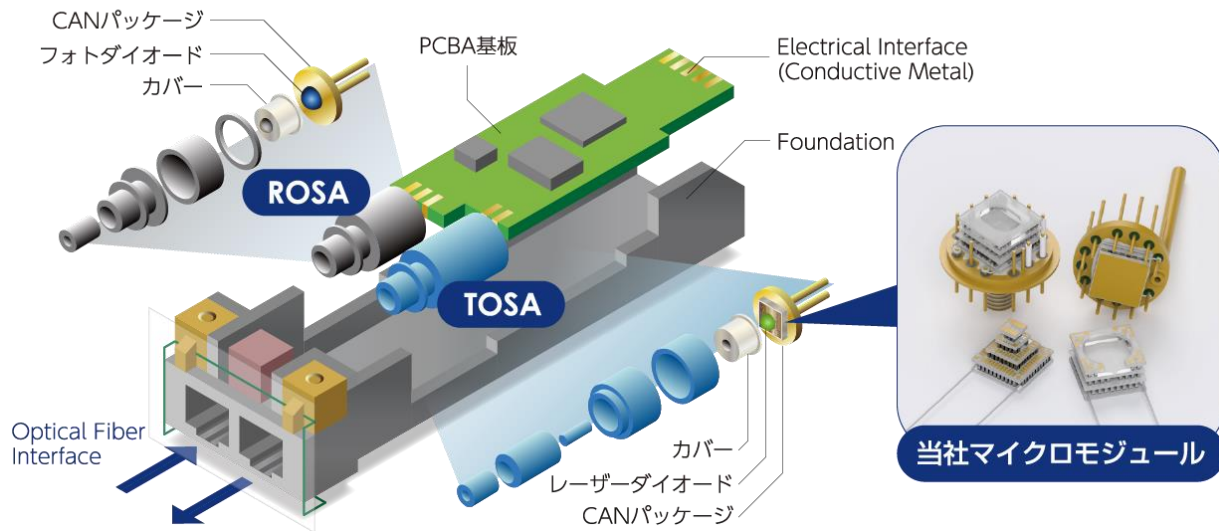
【投資・キャパ】

- ・生産ライン自動化により生産効率の向上進む
- ・中国外生産も検討

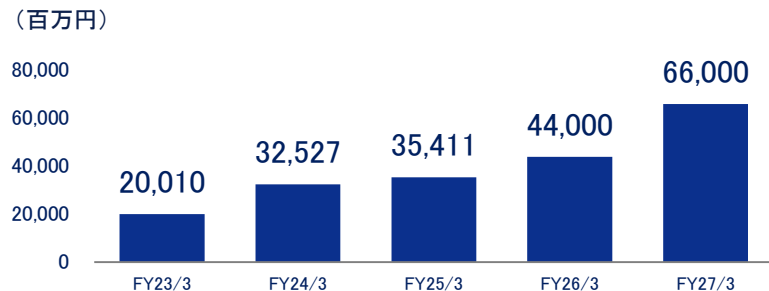
生成AIに関する取り組み

- サーバー通信量増大に伴う大容量通信ニーズの高まり
 ⇒5G通信機器、大容量の光トランシーバ需要の増大⇒サーモジュールへの好影響
 (特に大容量タイプ(800GB~)では大手顧客の供給シェアをもつ)
- ロジック半導体(GPU)の需要増大による半導体製造装置関連への恩恵も受ける

オプティカルトランシーバの基本構造



売上高の推移



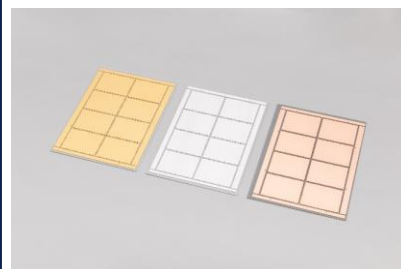
量産スケジュール

	FY2024	FY2025	FY2026
四川工場	稼働	本格稼働	⇒
マレーシア工場	稼働開始	稼働	本格稼働

内江、マレーシアで計400億円程度のキャパ増強



四川新工場(内江)



パワー半導体絶縁基板

【2023年総括】

- ・年後半に調整局面あるも需要は拡大トレンド、東台工場のキャパ拡充が奏功し、62%の増収、グローバルトップ級へポジションアップ
- ・四川新工場、マレーシア新工場を設立、キャパ増加へ積極投資

【中期業績見通し】

- ・パワー半導体基板の需要拡大は継続する見通し、
- ・DCB、AMB、DPCの製品レンジ拡充

【投資・キャパ】

- ・四川新工場、マレーシア新工場の稼働
- ・自動化が進展、生産効率の向上が進展

- 2024年1月から稼働開始。現在主要顧客からの製品認証を進め、年後半からの量産化へ向け準備中

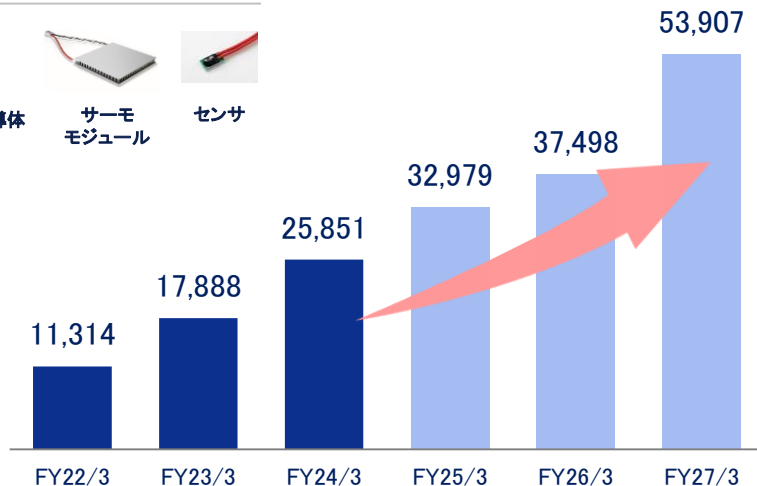
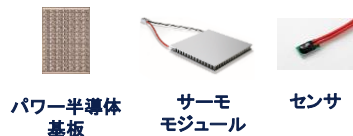


- 次世代自動車マーケットの中長期的な拡大を取込むべく、パワー半導体基板、サーモモジュール等の車載向け売上の戦略的な拡大を図る

当社の車載向け製品売上高

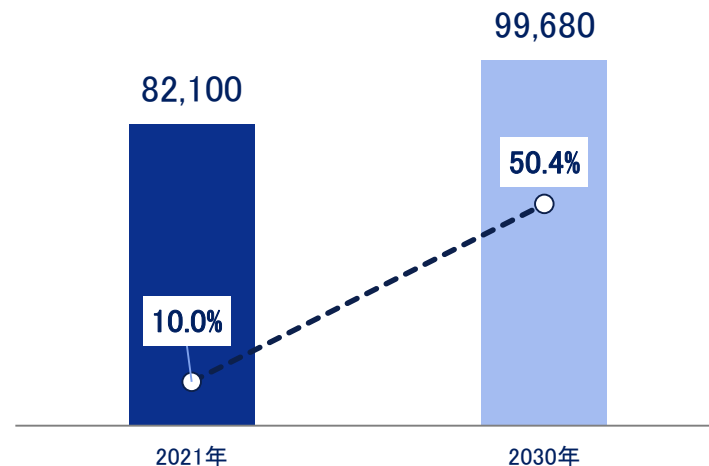
(百万円)

車載向け製品の一例



世界自動車販売台数(次世代自動車)予測

■ 新車販売台数(単位:千台)
-○- うち次世代自動車(XEV)の比率



生産現場のデジタル化・自動化・見える化を推進

- 中国生産拠点でERP、MESを始め、様々なシステム導入が進み、生産の見える化、効率化、品質の向上が実現（AI活用、ロボットの積極導入）
⇒自動化・省人化・効率化により、工場の競争力・優位性の強化を推進
日本、マレーシア新拠点でも自動化投資を積極化・水平展開



自動搬送システム



自動倉庫システム



自動検査装置

モノづくりにおけるDX化を推進し、生産性及び品質の向上に取り組む

- 事業成長を実現するため、人材重視を重要な経営方針と位置付け、高度人材の採用、研修制度の拡充等を積極的に進める
- 事業・地域を超えたコミュニケーションを活発にし、企業文化を共有し、協働の輪を広げてゆく



中国においても高度人材の採用を積極的に進めており、上海の中国本社や各事業の研究院で製品開発等に取り組む

主な工場新設・生産能力増強の状況

2024年以降の成長へ向けて、工場の新・増設を着々と進め、生産能力を拡大中。以下は現時点の主な予定

対象事業	所在地	2023	2024	2025	2026	2027	2028	生産能力想定 (億円)
パワー半導体用基板	中国 東台・内江	稼働開始	少量生産	フル稼働				680
パワー半導体用基板	マレーシア		稼働開始	少量生産	フル稼働			150
セラミックス	日本 石川県	稼働開始	少量生産	フル稼働				140
セラミックス シリコンパーツ	中国 常山	稼働開始	少量生産	フル稼働				150
石英坩堝	中国 銀川	稼働開始	少量生産	フル稼働				340
金属加工・石英 セラミックス	マレーシア		稼働開始	少量生産	フル稼働			250
マテリアル・洗浄	日本 熊本県			稼働開始	少量生産	フル稼働		70

- 石英坩堝・シリコンパーツ事業、シリコンウェーハ事業につき、上場審査中

事業	部品洗浄		石英坩堝・シリコンパーツ		パワー半導体用基板		シリコンウェーハ（持分法）	
会社名	安徽富楽徳科技發展股份有限公司		寧夏盾源聚芯半導体科技股份有限公司		江蘇富楽華半導体科技股份有限公司		杭州中欣晶圓半導体股份有限公司	
略称	FTSVA		FTNC		FLH(旧FTSJ)		CCMC	
現在の出資比率	50.23%*		60.13%		55.10%		23.05%	
上場市場	深セン・創業板		深セン・主板		上海・科創板		上海・科創板	
上場アドバイザー	光大証券		東方証券承销保荐		華泰綜合証券		海通證券	
直近評価額**	1,527億円（5/28付時価総額）		1,155億円		1,604億円		3,145億円	
新株発行予定比率	25%		25%		10%以上		10%以上	
進捗・目標スケジュール	上場アドバイザー登録	2022年	2020/8/11	2021/11/4	—	—	2021/10/20	
	上場申請提出	12月30日	2021/6/28	2023/6/30	未定	未定	2022/8/30	
	上場審査合格	上場完了	2022/5/6	—	—	—	—	
	上場正式承認		2022/11/16	—	—	—	—	
	上場予定日（目標）		2022/12/30	2024年後半（目）	未定	未定	2024年後半（目）	

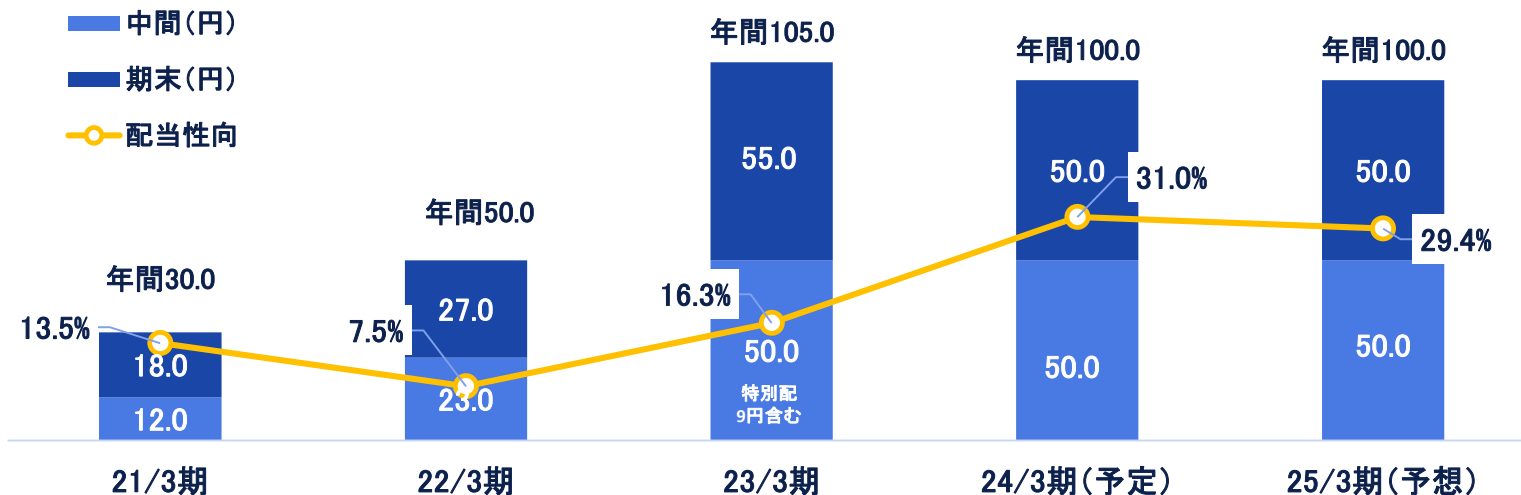
*FTSVA出資比率は上場後の数値を記載。

**評価額はFTSVA以外は2021年以降の第三者割当増資時に算定した株価で計算、中国元＝20.83円（2024/3/29TTM）

【新配当方針】

株主還元の増加を重視し、
配当は財務・投資機会の状況を考慮して判断するが、
配当性向は20%~30%を意識して、株主還元の拡充に努める

1株当たり配当金の推移

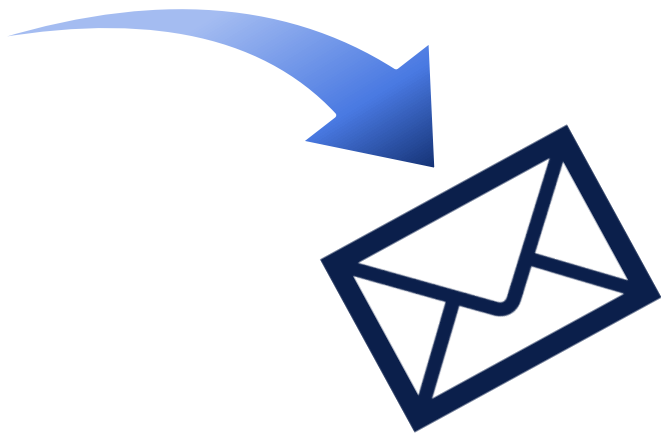


長期業績目標は継続も、キャッシュフロー及びROE・ROIC向上を図りながら実現を図る

2030年度に売上高**5,000**億円 当期純利益**500**億円の達成を目指す！



IRポータルサイト「IRSTREET」にて、
当社のIRニューズを日英にて掲載・メールにて配信しております
ぜひ以下のURLよりご登録ください



■ 日本語でのご登録

[https://ircms.irstreet.com/member_registration/new_u.php?site=1&language=1&brand_selection=0®ist_brand_select\[\]=85](https://ircms.irstreet.com/member_registration/new_u.php?site=1&language=1&brand_selection=0®ist_brand_select[]=85)

■ 英語でのご登録

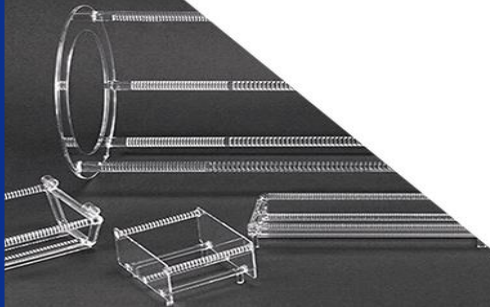
[https://ircms.irstreet.com/member_registration/new_u.php?site=2&language=2&brand_selection=0®ist_brand_select\[\]=85](https://ircms.irstreet.com/member_registration/new_u.php?site=2&language=2&brand_selection=0®ist_brand_select[]=85)



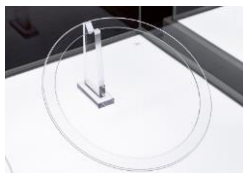
Ferrotec
Ferrotec Holdings Corporation



Appendix



半導体製造装置向け治具・消耗材(当社主力のマテリアル製品群)



石英



シリコンパーツ



セラミックス



CVD-SiC

当社製品群の強み: 設備投資連動型(真空シール)のみでなく、**半導体デバイスメーカーの生産稼働連動型リピート消耗材(マテリアル製品)**、サービス(洗浄・再生ウェーハ)をラインアップ



真空シール

※半導体・FPD
製造装置部品
(市場占有率:65%(TOP))



金属精密加工

※今後の中国国内顧客
(工場)増で伸長の見通し



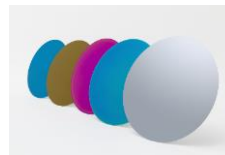
装置部品洗浄

※中国市場に特化



石英坩堝

※半導体・太陽電池向け



再生ウェーハ

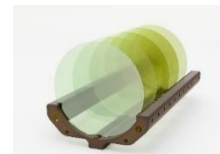
※中国市場に特化
(22/3期~新規事業)

持分法適用関連会社での事業



シリコンウェーハ

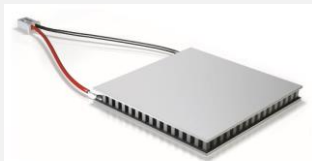
※月産能力6インチ 42万枚、8インチ 45万枚
12インチ25万枚



SiCウェーハ

※開発~量産化
(22/3期~新規事業)

サーモジュール



※自動車・半導体製造装置・通信・医療バイオ・民生品など、温度調整デバイスとして用途が拡大中
(市場占有率:36%(TOP))



チラー

チラー(恒温水循環装置)は、水などの循環する液体を予め設定した温度に冷却/加熱しながら供給する装置。設備や装置にある熱源などの対象物を一定の温度に保つことに用いられる

パワー半導体用絶縁基板



※世界の消費電力削減のトレンドに対応し、パワー半導体顧客からの需要が拡大中(アルミナセラミックス基板に銅回路を接合する DIRECT COPPER BONDING技術)

パワー半導体のアプリケーション



磁性流体



※自動車スピーカーや、高音質TVスピーカー、スマホのバイブレーション向けへの用途が拡大中
(市場占有率:80%(TOP))

温度センサ(サーミスタ) ※大泉製作所



※サーミスタは温度変化に対し、極めて大きな抵抗変化を示す半導体セラミックス。車載・家電・光通信などの温度センサとして幅広く使用され、車両電動化やデジタル化で需要拡大中

24/3期 製品別売上高詳細(上期・下期)

(百万円)	23/3期 実績			24/3期 実績					
	通期	上期	下期	通期	前期比	上期	前年同期比	下期	前年同期比
半 導 体 等 装 置 関 連	132,194	63,791	68,403	130,072	△1.6%	60,257	△5.5%	69,815	2.1%
真空シール	27,976	12,833	15,142	25,242	△9.8%	11,730	△8.6%	13,512	△10.8%
石英製品	28,837	13,983	14,854	28,242	△2.1%	11,584	△17.2%	16,658	12.1%
シリコンパーツ	17,542	9,325	8,217	14,604	△16.7%	7,712	△17.3%	6,892	△16.1%
セラミックス	27,194	13,030	14,164	24,314	△10.6%	11,657	△10.5%	12,657	△10.6%
CVD-SiC	4,812	1,962	2,850	6,836	42.1%	2,999	52.9%	3,837	34.6%
EBガン・LED蒸着装置	8,036	3,907	4,129	5,935	△26.1%	3,011	△22.9%	2,924	△29.2%
ウエーハ加工(連結対象外)	236	85	151	129	△45.3%	43	△49.4%	86	△43.0%
再生ウエーハ	1,501	652	849	1,780	18.6%	753	15.5%	1,027	21.0%
部品洗浄	12,170	5,939	6,231	11,719	△3.7%	5,424	△8.7%	6,295	1.0%
石英坩堝	3,891	2,075	1,816	11,268	189.6%	5,341	157.4%	5,927	226.4%
電 子 デ バ イ ス	53,024	23,073	29,952	67,600	27.5%	32,840	42.3%	34,760	16.1%
サーモモジュール	23,266	11,546	11,721	22,893	△1.6%	10,640	△7.8%	12,253	4.5%
パワー半導体基板	20,011	7,919	12,092	32,527	62.5%	16,103	103.3%	16,424	35.8%
磁性流体・その他	936	485	451	922	△1.5%	398	△17.9%	524	16.1%
センサ	8,811	3,123	5,688	11,255	27.7%	5,697	82.4%	5,558	△2.3%
そ の 他	25,590	10,640	14,950	24,757	△3.3%	12,396	16.5%	12,361	△17.3%
合 計	210,810	97,505	113,305	222,430	5.5%	105,494	8.2%	116,936	3.2%

※数値については一部丸め処理を行ったものを記載

25/3期 セグメント・製品別の業績予想(上期・下期)



(百万円)	24/3期 実績			25/3期 予想					
	通期	上期	下期	通期	前期比	上期	前年同期比	下期	前年同期比
半 導 体 等 装 置 関 連	130,072	60,257	69,815	138,185	6.2%	64,671	7.3%	73,514	5.3%
真空シール	25,242	11,730	13,512	29,178	15.6%	13,656	16.4%	15,522	14.9%
石英製品	28,242	11,584	16,658	28,849	2.1%	13,501	16.5%	15,348	△7.9%
シリコンパーツ	14,604	7,712	6,892	14,333	△1.9%	6,708	△13.0%	7,625	10.6%
セラミックス	24,314	11,657	12,657	23,913	△1.6%	11,191	△4.0%	12,722	0.5%
CVD-SiC	6,836	2,999	3,837	7,555	10.5%	3,536	17.9%	4,019	4.8%
EBガン・LED蒸着装置	5,935	3,011	2,924	5,720	△3.6%	2,677	△11.1%	3,043	4.1%
ウエーハ加工(連結対象外)	129	43	86	99	△23.3%	46	7.0%	53	△38.4%
再生ウエーハ	1,780	753	1,027	3,756	111.0%	1,758	133.5%	1,998	94.5%
部品洗浄	11,719	5,424	6,295	12,508	6.7%	5,854	7.9%	6,654	5.7%
石英坩堝	11,268	5,341	5,927	12,274	8.9%	5,744	7.5%	6,530	10.2%
電 子 デ バ イ ス	67,600	32,840	34,760	72,393	7.1%	33,880	3.2%	38,513	10.8%
サーモモジュール	22,893	10,640	12,253	24,015	4.9%	11,239	5.6%	12,776	4.3%
パワー半導体基板	32,527	16,103	16,424	35,411	8.9%	16,573	2.9%	18,838	14.7%
磁性流体・その他	922	398.4	523.6	1,188	28.9%	556	39.6%	632	20.7%
センサ	11,255	5,697	5,558	11,779	4.7%	5,512	△3.3%	6,267	12.8%
そ の 他	24,757	12,396	12,361	24,422	△1.4%	11,449	△7.6%	12,973	5.0%
合 計	222,430	105,494	116,936	235,000	5.7%	110,000	4.3%	125,000	6.9%

※数値については一部丸め処理を行ったものを記載

Copyright © Ferrotec Holdings Corporation. All Rights Reserved.

- 本資料に掲載されている将来見通しの記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因の仮定を前提としております。
- 実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。業績に影響を与える要素には、国際情勢、経済情勢、製品の需給動向、原材料価額及び市況、為替レートなどが含まれますが、これに限定されるものではありません。
- 本資料中の定量目標などは、あくまで中長期的な戦略、ビジョン等を示すものであり業績予想ではありません。当社はこれらについて情報を更新する義務を負いません。
- 正式な業績予想は、東京証券取引所規則に基づく決算短信での開示をご参照ください。

<本件照会先>

IR・広報部 03-3281-8186